

第89回講演会レーザー加工学会 大阪大学 銀杏会館

1日目 2018年5月23日(水)

昼食休憩(12:00~13:00)			
ホール			
プレナリーセッション			
13:00	【基調講演1】レーザー加工のモニタリングと知的生産システム	小林 洋平 (東京大学)	
13:50	【基調講演2】(仮)SIP革新的設計生産技術「次世代レーザーコーティング」および「高輝度青色半導体レーザー開発」	塚本 雅裕 (大阪大学)	
総会 (14:40~15:10)			
Coffee break (15:10~15:20)			
ホール		大会議室	
23A1	レーザー加工の優位性—競合加工技術との比較	木谷 靖	23B1 短パルスレーザーを駆使した細胞制御
15:20	【特別講演】レーザー・電子ビーム・アークによる3D金属積層造形技術の比較	木寺 正晃 (愛知産業㈱)	15:20 【特別講演】短パルスレーザーを応用した眼科医療機器開発
16:00	溶断工場に用いられる各種切断機の性能と特長	山本 健太郎 (日酸TANAKA㈱)	16:00 短パルスレーザーを駆使した細胞組織化・疾病メカニズムの解明
16:30	レーザー溶接と電子ビーム溶接の比較	西原 啓三 (東成エレクトロビーム㈱)	16:30 超短パルスレーザーを用いた機能性ポリマーの3次元バイオチップデバイス作製
17:00	レーザー焼入れと高周波焼入れの比較	後藤 光宏 (富士高周波工業)	17:00 フェムト秒レーザー細胞制御による生体組織の治癒メカニズムの解明
17:30	終了		17:30 終了
懇親会 (17:45~19:30)		ポスター講演優秀賞発表	

2日目 2018年5月24日(木)

ホール		大会議室	
24A1	高効率・コンパクトレーザーおよびモニタリング技術	24B1	ナノ・マイクロ加工、産業応用
9:30	【特別講演】トルプの最新レーザー溶接システム	9:30	超短パルスレーザーによる金属加工プロセスの現象可視化
10:10	ファイバレーザーによる異種金属の接合	10:00	Beamshaping of High Power Single Mode UV Lasers
10:40	最新ファイバレーザー及び周辺機器とその応用	10:30	レーザーによる繊維への微細マーキングと眼鏡レンズ染色
11:10	(仮) Seam Tracking with Remote Laser Welding Head RLSK	11:00	Ni基超々合金のレーザー肉盛
昼食休憩 (11:40~12:40)		昼食休憩 (11:30~12:30)	
ホール		大会議室	
24A2	レーザー加工応用・適用事例	24B2	ピーニング
12:40	100 kWファイバレーザーによるビード整形工法	12:30	【特別講演】レーザーピーニングのこれまでとこれから
13:10	超伝導トカマク装置JT-60SAにおける真空容器内機器保守に向けたレーザー溶接ツールの開発	13:10	携帯型装置の開発に向けたレーザーピーニングの低出力化の検討
13:40	レーザークラッドバルブシート開発	13:40	ショットピーニングとレーザーピーニングの効果の違いとそのアプリケーション
14:10	レーザー積層造形法により作製した析出型Cu-Cr合金の特性	14:10	新しいレーザーピーニング技術：犠牲層を用いない大気中で施工可能なドライレーザーピーニング
14:40	フォトニック結晶構造ファイバによるハイパワー伝送技術		
Coffee break (15:10~15:30)		Coffee break (14:40~15:00)	
ホール		大会議室	
24A3	レーザー加工現象解析・シミュレーション	24B3	バターニング技術
15:30	レーザー切断加工におけるダイナミック現象—熱源スポットの形成と切断への関与—	15:00	【特別講演】レーザー照射とグリオキシル酸銅錯体を用いた大気中での銅バターニング
16:00	【特別講演】計算科学シミュレーションコード SPLICE によるレーザー溶融・凝固プロセスの評価	15:40	【特別講演】レーザー転写技術を用いた強誘電体薄膜の圧電基板への集積化
16:40	(仮)SLM過程におけるレーザー照射部周りの温度分布と溶融池形状の予測	16:20	レーザー技術によるストレッチャブル配線バターニング
		16:50	レーザー彫刻印刷版によるプリンテッドエレクトロニクスへの展開
17:10	終了	17:20	終了